

N4000-13

高速多功能环氧树脂
层压板和半固化片



优点

- 低 DF 和 DK
- 出色的厚度控制可实现紧密公差
- 支持先进技术 PWB 设计
- 具有多种结构

产品应用

- 高速存储网络
- 互联网交换机/路由系统
- 无线通信基础设施
- 背板



N4000-13 系列是一种增强型环氧树脂体系，其设计制造旨在提供优异的热性能和高信号速率/低信号损耗属性，以用于高速存储网络及无线通信基础设施。

优异的电气性能

- 出色的厚度控制可实现紧密公差阻抗应用
- 支持先进技术 PWB 设计
- 低 DK 和 DF

热性能与机械性能

- $T_g > 210^\circ\text{C}$
- 低 Z-CTE 和经过验证的耐 CAF 性为射频和数字应用提供长期可靠性
- 无铅组装兼容性
- 长期可靠性

优异的 CAF 性能

- 高温回流焊之后的耐 CAF 材料

高 T_g FR-4 加工

- 类似于传统高 T_g FR-4 材料的工艺
- 在 193°C 和 275-350 psi 下压制 90 分钟

符合 UL 94V-0 和 IPC-4101/29, /98, /99, /101 规格
UL 档案号: E36295

属性	条件	典型值	单位	试验方法
电气性能				
介电常数 (50% 树脂含量)	@ 2.5 GHz (Split Post Cavity)	3.7		
	@ 10 GHz (Stripline)	3.6		IPC-TM-650.2.5.5.5
耗散因数 (50% 树脂含量)	@ 2.5 GHz (Spilt Post Cavity)	0.009		
	@ 10 GHz (Stripline)	0.009		IPC-TM-650.2.5.5.5
体积电阻率	C - 96 / 35 / 90	10 ⁸	MΩ - cm	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E – 24 / 125	10 ⁷		
表面电阻率	C - 96 / 35 / 90	10 ⁷	MΩ	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E - 24 / 125	10 ⁷		
电气强度		4.7x10 ⁴ (1200)	V/mm (V/mil)	IPC-TM-650.2.5.6.2
热性能				
*玻璃化转变温度 (Tg)	DMA(°C) (Tan d Peak)	240	°C	IPC-TM-650.2.4.24.3
降解温度 (TGA)	Degradation Temp (TGA) (5% wt. loss)	350	°C	IPC-TM-650.2.4.24.6
T-260	Time to delamination @ 260°C	30+	minutes	IPC-TM-650.2.4.24.1
T-288	Time to delamination @ 288°C	10+	minutes	IPC-TM-650.2.4.24.1
导热系数		0.350	W/mK	ASTM E1461
机械性能				
剥离强度	1 oz (35μ) Cu	1.31 (7.9)	N/mm (lbf/inch)	IPC-TM-650.2.4.8
	After Solder Float	1.31 (7.5)	N/mm (lbf/inch)	IPC-TM-650.2.4.8
X / Y CTE	-40°C to + 125°C	10 / 14	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.41
Z 轴 CTE Alpha 1 (50°C 至 Tg)		70	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.24
Z 轴 CTE Alpha 2 (Tg 至 260°C)		280	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.24
Z 轴膨胀系数	50°C to 260°C	3.5	%	IPC-TM-650.2.4.24
杨氏模量 (X / Y)		28.5 / 22.4 (4.2 / 3.3)	GN/m2 (psi x 10 ⁶)	ASTM D3039
泊松比 (X / Y)		0.13 / 0.11		
物理/化学性能				
吸水率		0.1	wt. %	IPC-TM-650.2.6.2.1

- 提供的所有试验数据均为典型值，并非规范值。如需查看关键规格公差，请直接联系公司代表。
- N4000-13 可制造的层压板厚度为 2 mil (0.05 毫米) 及以上。
- N4000-13 提供最常见的面板尺寸。
- 请联系 AGC 了解能否提供任何其他结构、铜重量和玻璃样式，包括超低粗糙度铜箔和 RTFOIL®